

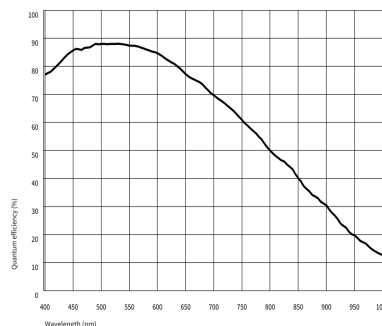
■ 양산 단계
이 모델은 양산 단계에 있으며 장기간 구매 및 사용이 가능합니다.



사양

센서

센서 타입	CMOS 모노
셔터	Global Shutter
센서 특성	선형의
픽셀 등급	3 MP
해상도	3.20 Mpix
해상도 (h x v)	2064 x 1552 픽셀
종횡비	4:3
ADC	12 bit
색 심도(카메라)	12 bit
광학 센서 등급	1/3.1"
광학 영역	4.644 mm x 3.492 mm
광학 센서 대각선	5.81 mm 1/3.1"
픽셀 크기	2.25 μ m
CRA (주광선 각도)	8 °
제조사	Sony
센서 모델	IMX900-AMR-C
게인(마스터/RGB)	15.8x/-
AOI 수평	동일한 프레임 레이트
AOI 수직	프레임 레이트 증가
AOI 이미지 너비/단차 너비	264 / 24
AOI 이미지 높이/단차폭	16 / 8
AOI 위치 그리드(수평/수직)	8 / 8
수평 비닝	프레임 레이트 증가
수직 비닝	프레임 레이트 증가
비닝 방법	수평: 평균 / 수직: 평균
비닝 요소	2x2
수평 decimation (서브샘플링)	-
수직 decimation (서브샘플링)	-
decimation (서브샘플링) 방법	-



모델

프레임 레이트 프리런 모드	67 fps
프레임 레이트 트리거(연속)	70 fps
프레임 레이트 트리거(최대)	70 fps
노출 시간(최소 - 최대)	0.016 ms - 1999 ms
전력 소비	0.5 W - 1 W
이미지 메모리	-

HDR

모드	QuadHDR
----	---------

주변 조건들

PCB 버전들의 경우, 각각의 문서 내의 별도 힌트들을 참조하십시오.

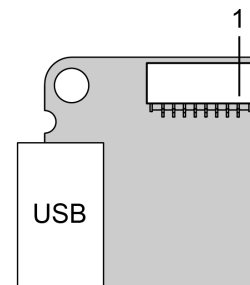
작동 중 허용되는 장치 온도	0 °C - °C / 32 °F - 32 °F
작동 중 허용되는 주변 온도	0 °C - 40 °C / 32 °F - 104 °F
보관 중 허용되는 주변 온도	-20 °C - 80 °C / -4 °F - 176 °F
습도(상대, 비응축)	20 % - 80 %

커넥터들

인터페이스 커넥터	USB 3.0 micro-B
I/O 커넥터	8-핀 Wuerth 커넥터
전력 공급	USB 케이블

핀 할당 I/O 커넥터

1	전압 출력 3.3 V
2	접지 (GND)
3	옵토커플러 없이 플래시 출력 - Line 1
4	옵토커플러 없이 트리거 입력 - Line 0
5	범용 I/O (GPIO) 1 - Line 2
6	범용 I/O (GPIO) 2 - Line 3
7	접지 (GND)
8	USB 전원: 5 V, 최대 400 mA



디자인

렌즈 마운트	CS- / C-마운트
IP 코드	-
치수 H/W/L	32.5 mm x 32.5 mm x 14.0 mm
무게	20 g
하우징 소재	-

Features

카메라 내 이미지 사전 처리 기능 목록입니다.

표의 모든 기능은 호스트 컴퓨터에서 이미지 전처리를 위한 IDS peak 소프트웨어를 통해 사용할 수 있습니다(센서 모델에 따라 다름).

이미지 획득

Freerun	✓
Software trigger	✓
Hardware trigger	✓
Trigger controlled exposure	-
Denoiser	-
Long exposure	-
Line scan	-

기술적인 수정을 받아야 함 (2026-09-11)

2의 페이지 3

www.ids-imaging.kr

IDS Imaging Development Systems GmbH

Dimbacher Str. 10 · 74182 Obersulm · Germany · Phone +49 7134 96196-0 · E-mail info@ids-imaging.com

U3-33D4XLS-M-GL Rev.1.2 (1012024)

깜박임	Flashing	✓
	PWM flashing	-
이미지 조정	Auto exposure	-
	Auto gain	-
	Auto whitebalance	-
	Color correction	-
	Gamma	-
	LUT	-
	Mirror/flip	X/Y
온보드 이미지 처리	Pixel formats	Mono8 Mono10g40IDS Mono12g24IDS
	Region of interest	✓
	Decimation (FPGA)	-
	Decimation (Sensor)	
	Binning (FPGA)	-
	Binning (Sensor)	2x2 Increases frame rate.
기타	Chunks	-
	Sequencer	-
	Events	-
	Firmware update	✓
	1st supported firmware version	3.62.25422